



tesa HAF® 8410

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



reactive HAF ฟิล์มที่ติดได้ด้วยความร้อน สีเหลืองอำพัน หนา 60 ไมครอน

Product Description

tesa® HAF 8410 เป็นฟิล์มกาวที่ติดด้วยการกระตุ้นด้วยความร้อน กาวสองด้าน สีเหลืองอำพัน ประกอบด้วย phenolic resin และ nitrile rubber

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติด chip module ที่เชื่อถือได้
- เหมาะสำหรับการ์ด PVC, ABS, PET และ PC
- สามารถใช้งานได้ดีกับ implanting lines ทั่วไป
- โดดเด่นในด้านความทนทานต่อการเสื่อมสภาพ
- ยึดหยุ่นตลอดอายุการใช้งานเนื่องจากมีส่วนประกอบรับเบอร์อยู่สูง

การใช้งาน

tesa® HAF 8410 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการฝัง chip-modules ลงในสมาร์ทการ์ด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการยึดติดวัสดุทนความร้อน เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้และสิ่งทอ (เช่น friction liners สำหรับ clutches)

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| • ตัวเทป | none | • ความหนารวม | 60 µm |
| • ประเภทของกาว | nitrile rubber / phenolic resin | • สี | สีเหลืองอำพัน |
| • ประเภทของแผ่นลอก | glassine | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- แรงยึดเกาะ (แรงเฉือนแบบไดนามิก) 12 N/mm²

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางด้านเทคนิคสำหรับการใช้งานกับสมาร์ทการ์ด:

ค่าต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพารามิเตอร์ของเครื่องมือที่จะใช้ในเบื้องต้น โปรดทราบว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักร รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด ชิพโมดูลและข้อกำหนดของลูกค้า

1. การเคลือบติดเทปเบื้องต้น:

ช่วงการติดเคลือบเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบบนสายพานโมดูล ขั้นตอนการเคลือบเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบต่ออายุของเทป สายพานโมดูลที่ได้รับการเคลือบติดเทปสามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยใช้เวลาเท่ากับอายุการใช้งานของเทป

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08410>



tesa HAF® 8410

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าเครื่องจักร:

- อุณหภูมิ 120 – 140 °C
- แรงกดทับ 2 – 3 บาร์
- เวลา 1.5 – 2.5 ม./นาที

2. การฝังโมดูล:

ระหว่างการฝังโมดูล

โมดูลที่เคลือบจะถูกโค้ทจากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าในช่องของบัตร์และติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตร์โดยความร้อนและแรงกดทับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ implanting line สามารถใช้วิธีการกดทับขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนก็ได้ ปัจจุบันเครื่องฝังชิพส่วนใหญ่ใช้แรงกดด้วยความร้อนแบบหลายขั้นตอน

การตั้งค่าเครื่อง - การติดกดทับแบบขั้นตอนเดียว (single step):

- อุณหภูมิ 180 – 220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

กระบวนการกดทับหลายขั้นตอน (การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 180 – 220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที / 3 x 0.5 วินาที

¹ อุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน มีข้อแนะนำการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุบัตร์ที่แตกต่างกัน ดังนี้:

PVC and ABS: 180 – 190 °C

PET and PC: 190 – 200 °C

ค่าความแข็งแรงของการยึดติดสามารถจัดหาให้ได้ภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

ค่าที่ได้ได้รับการันตีจากการทดสอบด้วยจำนวนจำกัดในแต่ละชุดการผลิต (วัสดุ: แผ่นทดสอบ Etched aluminium/ สภาวะการติด: อุณหภูมิ = 120 °C; p = 10 บาร์; เวลา = 8 นาที)

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาวะการเก็บรักษาและอายุการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน tesa® HAF



tesa HAF® 8410

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08410>